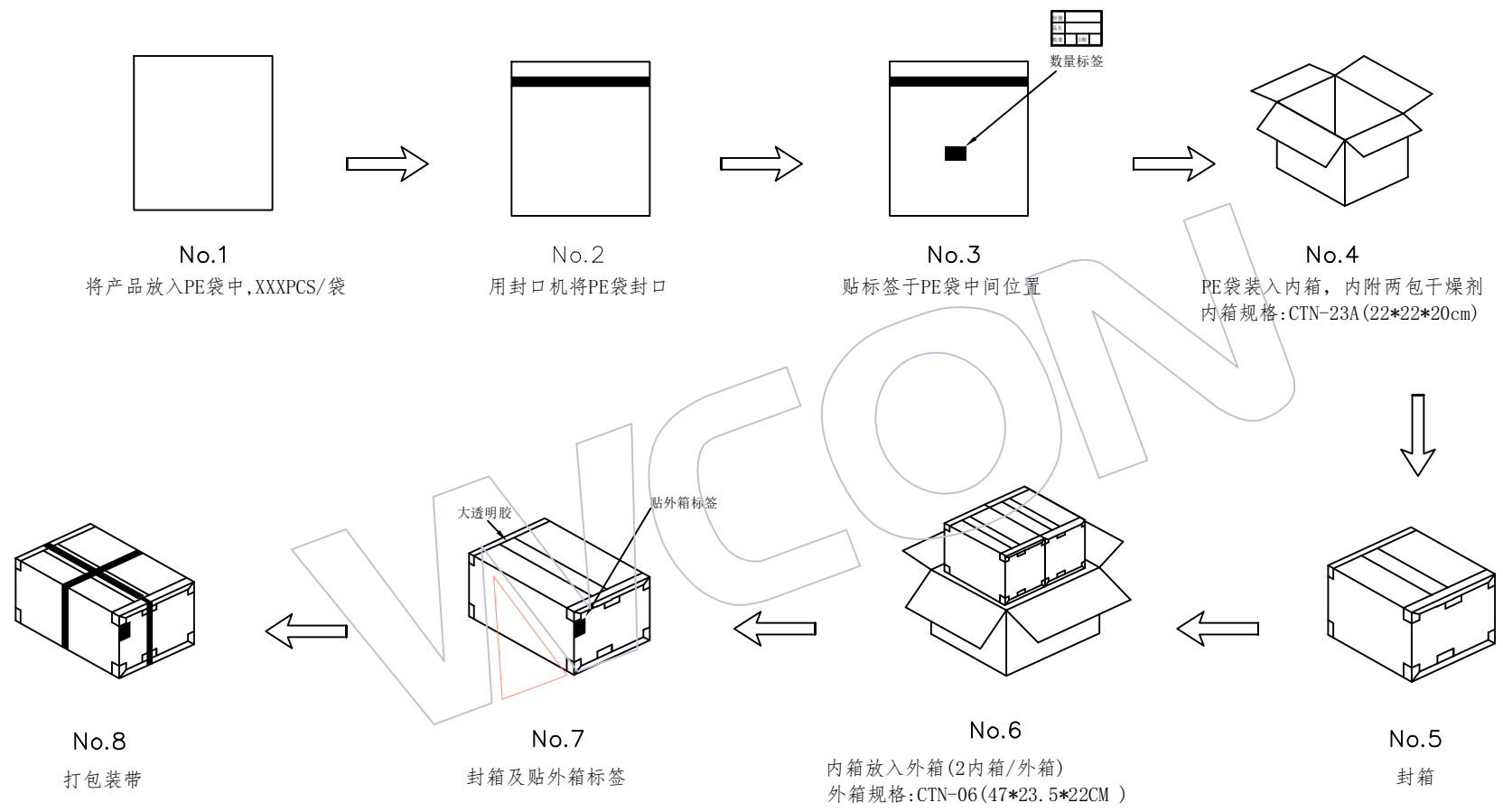


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------------|--------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|------------|---|---|----------------|
| 变更 记录 | | | | | | 零件图 | | 颜色 | SCALE 1:1 | | WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD | | |
| | | | | | | X. | | 材质 | UNIT | mm | | | |
| | | | | | | X.X | ±0.10 | DESIGN | 苏 珊 | 2023/03/16 | | SIZE | A4 |
| | | | | | | X.XX | ±0.05 | CHECK | | | | SHEET | 1/1 |
| | | | | | | X.XXX | ±0.02 | APPROVE | | | | 料号 PART NO. | WF4141-3HXXW01 |
| | A0 | 2023/03/16 | NEW | | | Angle | | 核准 | | | 品名 TITLE: | 4.14mm Wafer, Housing, Three Row, XXP, 袋装规范 | |
| | 版次 | 日期 | 变更说明 | 变更 | 核准 | X. | ± 2' | 核准 | | | | | |
| | REV | DATE | MODIFICATION DESCRIPTION | CHANGE | APPROVE | DIM | TOL | APPROVE | | | | | |